

## ZO-HCG1050 导热硅胶片

### 产品介绍

ZO-HCG系列导热硅胶片，具有良好的导热性能，在相对较低的压力下就可以实现低界面热阻性能。应用于功率器件与散热铝片或机器外壳间，可以有效的排除空气，达到很好的填充效果。

ZO-HCG1050具有良好的柔软性能、回弹性，以及良好的绝缘耐压特性和热稳定性，使用安全、可靠。

### 性能参数

项目	单位	HCG1050	测试标准
颜色	-	黄色	目测
结构和成分	-	陶瓷填充硅胶	-
厚度	mm	0.2~14	ASTM D374
密度	g/cc	2.32+/-0.2	ASTM D792
硬度	Sc	8~60	ASTM D2240
导热系数	W/m.K	1.0	ASTM D257
热阻	@20PSI&1mm °Cin <sup>2</sup> /W	2.20	ASTM D5470
击穿电压	KV(1.0mm)	11.2	ASTM D149
体积电阻率	Ω.cm	4.5*10 <sup>10</sup>	ASTM D257
压缩比	%50PSI	60	ASTM D575-1991
拉伸强度	MPa	0.55	ASTM D412-1998A
延伸率	%	56.4	ASTM D412-1998A
介电常数	@1MHz	6.79	ASTM D150
介质损耗	-	0.0057	ASTM D150
防火性能	-	V-0	UL 94
热失重	%(120°C, 7d)	0.29	ASTM E595-2006
使用温度	°C	-50~200	-

### 产品特性

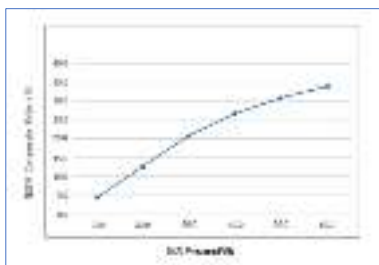
- ✓ 1.0W/m.k 导热系数，热阻抗较小
- ✓ 柔软，可压缩性好，表面自粘性
- ✓ 防火性能高
- ✓ 符合ROHS法规



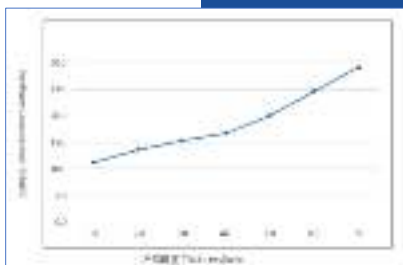
### 产品应用

- ✓ 冷却器件到底盘或框架结构之间
- ✓ 高速海量存储驱动
- ✓ 电源转换设备, 电池模组
- ✓ 记忆存储模块，汽车引擎控制单元

### 产品压缩率与压力关系



### 产品击穿电压及厚度关系



### 产品热阻与压力关系

